

番 号	C06018-SF01
発行日	2006年 10月 10日

仕 様 書

品名 : ペルチェモジュール

形式 : FPK2-19808NC

受領印欄

ご捺印の上1部返却願います。

承 認	確 認	作 成
		

1. 適用範囲

- 1-1 本仕様書は株式会社フジタカで取り扱うペルチェモジュールに適用する。
 1-2 本仕様書に関する改訂は、改良のため仕様変更する際に行なう。

2. 仕様

2-1 定格

定 格		備 考	
抵抗値	1.65 Ω ± 10%	注-1	
最大電流	8.5 A	注-2	
最大電圧	16.1 V	注-3	
	Th=27°C	Th=50°C	
最大吸熱量	51.6 W	58.0 W	注-4
最大温度差	85 °C	95 °C	注-5
半田融点	138°C(SN-Bi) / 235°C(Sn-Sb)		注-6
最大圧縮静荷重	1 MPa		

注-1 測定温度 27°C、AC 抵抗計 4 端子測定法による

注-2 最大温度差を得るための電流

注-3 最大温度差を得るための電圧

注-4 最大電流、最大電圧、温度差=0°Cにおける吸熱量

注-5 最大電流、最大電圧、吸熱量=0Wにおける温度差
 (各最大パラメータは真空度 10⁻² Torr の槽内で測定)

注-6 固相融点

2-2 モジュール構造
通常構造

2-3 使用半田

鉛フリー半田： Sn-Bi (58%)

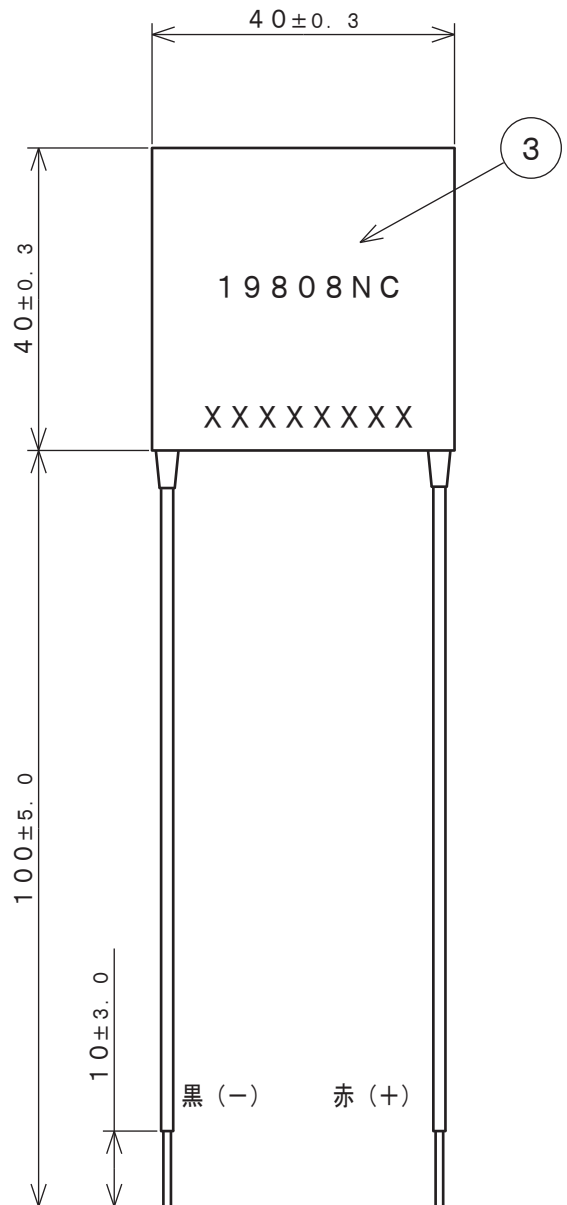
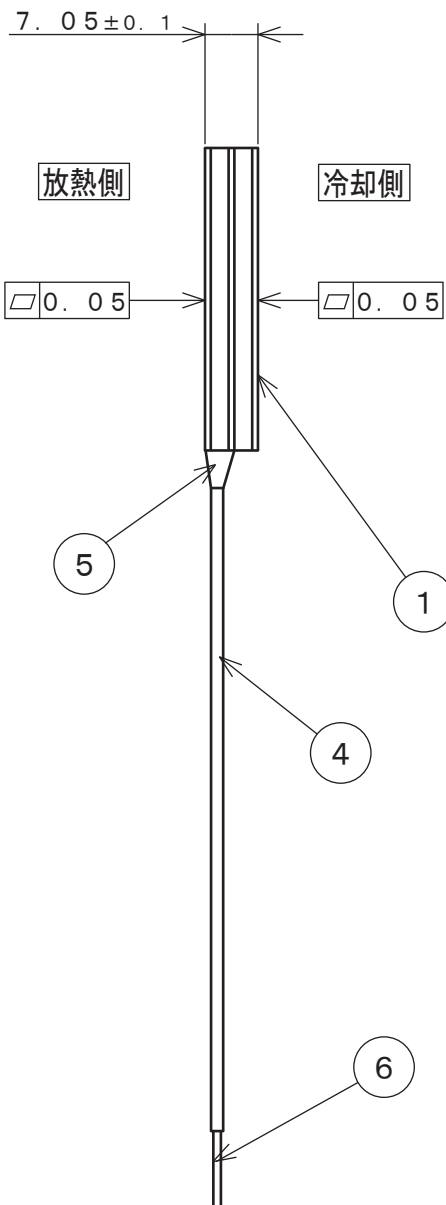
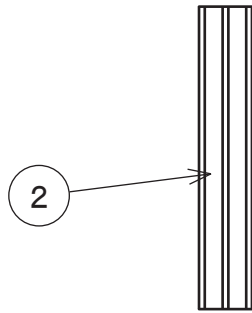
鉛フリー半田： Sn-Sb (5%)

2-4 外形図
別紙2-5 特性図
別紙

3. 使用上の注意

- 3-1 ペルチェモジュールをビスで締め付けて使用する場合は、モジュール面に均一に加重が加わるようにし、M4 ビス×2本、0.2~0.3 N・m のトルクでの締め付けを推奨します。
- 3-2 ペルチェモジュールの保管は、水漏れや結露の生じる可能性がある場所や、直射日光のあたる場所を避け、保管場所の温度と湿度は、5~35°C、20~75%RHとしてください。
- 3-3 通常の保管形態で 1 年間以上経過した場合は、使用前にリード線の半田付け性を確認することを推奨します。

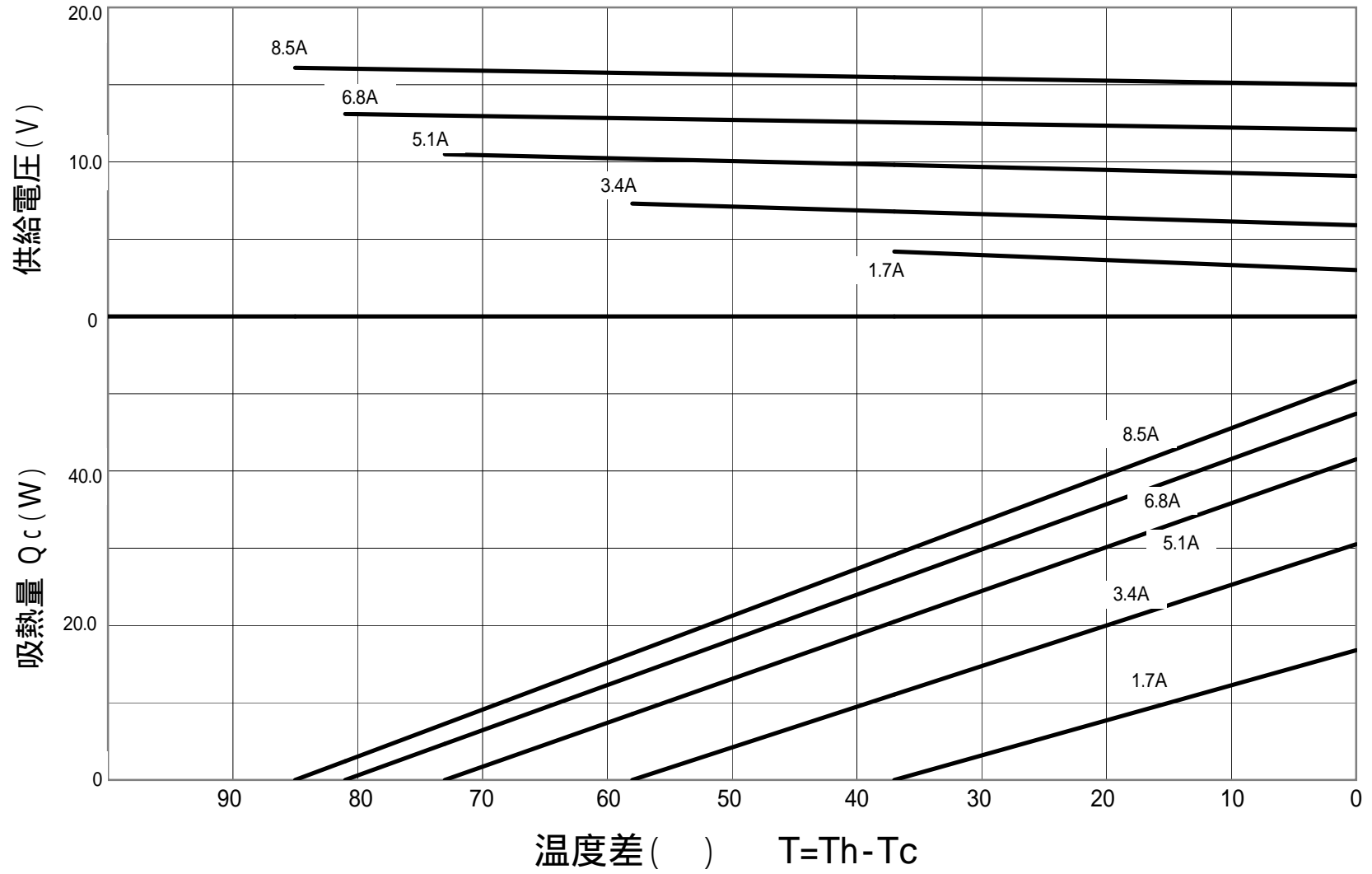
機種	ペルチェモジュール	
分類	外形図	
番号	名称	規格
1	セラミック基板	96%A 12O ₃ 、厚さ：0.76mm、白色
2	耐湿シール	KE347（信越シリコン）または相当品にてモジュールサイド面をシールする
3	捺印	冷却側セラミック表面に型名及びモジュールS/Nを捺印する
4	リード線	PVC被覆 UL1430、AWG#20相当品
5	リード線接合部	KE347（信越シリコン）または相当品にてリード線接合部をシールする
6	予備半田	リード線端部は、Sn-Sb半田で予備半田する



尺度	名称		
1 : 1	FPK2-19808NC		
検図	認可	図番	版数
N. S	F. H	C06018-PD02	0
製図	株式会社フジタカ		
N. S			
作成日	06.10.10		
訂符	改訂	年月日	点検

①			
②			
③			

F P K 2 - 1 9 8 0 8 N C 特性図 (Th=27)



F P K 2 - 1 9 8 0 8 N C 特性図 (Th=50)

